

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

深圳市景旺电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

(记录表编号：2025-0901)

投资者关系 活动类别	☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 一对一沟通	☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 其他
时间	2025 年 9 月 26 日		
地点/方式	上证路演中心网络互动		
参与单位 (或人员)	线上参与公司 2025 年半年度业绩说明会的投资者		
上市公司 接待人员	董事长：刘绍柏先生 董事兼总裁：刘羽先生 财务总监：孙君磊先生 董事会秘书：黄恬先生 独立董事：曹春方先生		
活动 主要内容	一、开场致辞 尊敬的各位投资者，大家好！欢迎大家参加深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会。在此，我谨代表景旺电子对各位投资者长期以来的关心和支持表示衷心的感谢！ 2025 年上半年，上游原材料价格高位震荡、贸易摩擦扰动全球供应链等外部挑战对 PCB 产业的供需产生了阶段性影响，公司保持战略定力，稳扎稳打，不断扩大汽车电子领域的既有优势，拓展 AI 服务器、高速网络通讯等新兴市场的能力边界，推动价值大客户的订单导入，以技术创新加速相关产品量产。报告期内，公司实现营业收入 70.95 亿元，同比增长 20.93%，归母净		

利润 6.50 亿元，同比降低 1.06%，扣除股份支付影响后的净利润 7.21 亿元，同比增长 9.55%。

出席本次业绩说明会的还有公司董事兼总裁刘羽先生、财务总监孙君磊先生、董事会秘书黄恬先生、独立董事曹春方先生。在接下来的问答环节，我们将本着真诚、专业的态度，就大家关心的问题回答与交流，谢谢！

二、问答环节

问：公司目前的产能利用率情况？信丰基地的产能爬坡是否顺利？

答：尊敬的投资者，您好！公司近期各项业务经营正常，汽车电子、算力硬件、消费电子等市场的需求保持暖意，产能利用率较高，环比有所提升。受益于汽车智驾产品需求旺盛及公司在客户端的供应份额提升，信丰高多层基地的产能爬坡与客户导入进度较快，当前在手订单覆盖产能爬坡需求。感谢您的关注！

问：公司在 AI 服务器领域的优势体现在哪里？

答：尊敬的投资者，您好！公司优势主要体现在：（1）重视研发投入，技术研发实力雄厚：2025 年上半年，公司可应用于数据中心、AI 服务器、HPC、高速光模块的高阶 HDI、PTFE 软硬结合板、高速 FPC、多层 PTFE 板，112G 交换机高多层高速板等产品实现量产，在服务器超高层 Z 向互联背板、Birch stream 平台高速 PCB、1.6T 光模块 PCB 等产品取得重大技术突破，同时开展了服务器 OKS 平台、224G 交换机等下一代产品技术预研。（2）与全球领先企业客户形成稳固战略合作关系：公司与全球各领域的头部客户建立长期战略合作，通过改善品质服务、加强研发投入、积极配合客户新产品开发和产能提升等多种方式，不断提升对客户的主动服务能力，近几年在 AI 服务器、光模块、高速交换机、AR/VR 等高附加值领域的认证布局和客户积累逐步转化为实质性订单。（3）持续加码投资，高端产能储备充足：公司持续发力以 HLC、HDI 为代表的 PCB 和 FPC 高端产能多年，规划总投资近百亿元，随着公司在全球生产基地布局的高端产能有序释放，预计 AI 服务器业务将为公司打开业绩增长新空间。感谢您的关注！

问：在珠海金湾追加的 50 亿投资将在什么时候形成新产能？

答：尊敬的投资者，您好！本次在珠海金湾追加 50 亿投资将用于 3 个方面：第一，在高多层工厂针对性的技术改造补齐瓶颈工序产能、在 HDI 工厂新增 AI 服务器高阶 HDI 产线，计划于 2025 年下半年实施完成并投入使用；第二，投资新建高阶 HDI 工厂，计划于 2025 年下半年开工建设、2026 年中投产；第三，利用储备用地增加投资强化关键工序产能，计划于 2027 年初建设、2027 年内投产。感谢您的关注！

问：下游市场需求变化很快，公司如何能抓住市场机遇呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品被广泛应用于汽车、新一代通信技术、数据中心、AIoT、消费电子、工业互联、医疗设备、新能源、卫星通信等领域，多元化产品布局使公司能更及时地抓住下游市场需求爆发的机遇，以强大的技术储备和研发能力紧跟产品应用的迭代更新，为客户提供一站式解决方案。感谢您的关注！

问：恭喜公司调入 MSCI 中国指数！请问后续市值管理工作有没有规划？

答：尊敬的投资者，您好！公司董事会和管理层十分重视公司在资本市场的表现，始终坚持做好经营管理，不断提升核心竞争力和盈利水平；严格遵守相关规定，不断提升公司信息披露质量，多渠道、多平台开展投资者互动和交流；公司结合未来发展目标，推出长效激励机制，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性；公司依据发展阶段与经营情况，制定了中长期分红规划，积极回馈广大投资者。感谢您的关注！

问：请问未来的业绩会大幅增长吗？公司的股价走势如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司业绩情况请关注后续披露的定期报告。二级市场股价波动受宏观经济形势、行业发展周期、市场情绪等多重因素影响，公司一直专注于自身的发展，致力于通过持续的业务增长为股东创造长期价值。感谢您的关注！

问：请问董事长，公司为什么要提前赎回景 23 转债？

答：尊敬的投资者，您好！结合当前市场情况及公司自身发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体

资产结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“景 23 转债”的提前赎回权利。目前“景 23 转债”已停止交易，2025 年 9 月 30 日为“景 23 转债”最后一个转股日，因“景 23 转债”二级市场价格（2025 年 9 月 25 日收盘价为 283.099 元/张）与赎回价格（100.515 元/张）差异较大，特提醒投资者注意在 9 月 30 日前（含当日）转股，否则可能面临较大投资损失。感谢您的关注！

问：请问董事长，如果景 23 转债不转股会怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！9 月 30 日为“景 23 转债”最后一个转股日，收市后未实施转股的“景 23 转债”将停止转股，按照 100.515 元/张的价格被强制赎回。因“景 23 转债”二级市场价格（2025 年 9 月 25 日收盘价为 283.099 元/张）与赎回价格（100.515 元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。感谢您的关注！

问：公司未来的分红计划和派息政策？

答：尊敬的投资者，您好！公司将结合公司中长期发展战略规划、公司经营状况和资金状况合理规划未来分红计划，兼顾现金分红的连续性和稳定性。公司已经发布了《未来三年（2025 年~2027 年）股东分红回报规划》，并制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。感谢您的关注！

问：公司目前现金流情况如何？是否有其他再融资计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前暂无明确的再融资安排，且目前公司的资产负债率尚低，截至 2025 年 6 月 30 日，账面货币资金 25.8 亿，经营性现金流较稳定，资金状况良好，公司将结合项目投资节奏、资金安排等因素审慎考虑，如有相关融资计划，公司会严格按照规范要求履行信息披露义务。感谢您的关注！

问：独立董事，请问公司尚未使用的募集资金用途及去向？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2025 年 6 月 30 日，“景 20 转债”尚未使用的募集资金余额为人民币 5,133.39 万元，全部放于募集资金专户，“景 23 转债”尚未使用的募集资金余额为人民币 24,947.20 万元，其中 15,000.00 万元临时补充流动资金待归还，9,947.20 万元存放于募集资金专户。公司在不影响募集资金使用和保障募集资金安全的前提下，为提高募集资金使用效

	率，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司收益，为全体股东提供稳定的回报，不会影响募集资金用途。感谢您的关注！ 问：请问公司中长期融资规划是怎样的？也请独立董事评价一下公司市值管理工作。 答：尊敬的投资者，您好！公司将根据公司战略布局规划、外部经营环境、相关政策变化及实际需求来制定公司中长期融资计划。公司高度重视市值管理工作，深耕印制电路板主航道，通过优化合规治理、稳健发展经营、加强投资者关系管理等方式，开展市值管理相关工作，积极向市场传递公司投资价值。感谢您的关注！ 三、结束致辞 尊敬的各位投资者，景旺电子 2025 年半年度业绩说明会即将结束，衷心感谢大家积极参与并提出宝贵意见！会后也欢迎广大投资者通过上证 e 互动、电话、邮箱等多种形式与我们继续保持沟通和交流。感谢各位投资者朋友对景旺电子的关注与支持，衷心祝愿大家投资顺利、生活愉快！谢谢！ 注：调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件	无
记录时间	2025 年 9 月 26 日整理